

No. : 201-03-897

製品仕様書  
PRODUCT  
SPECIFICATION

---

*6407Series*

STUD

京セラ株式会社  
KYOCERA Corporation

G	DCN21347	2021/09/27	H. Tamai		M. Yoshida
F	DCN-889	2015/08/06	S. Morita		N. Takahashi
O	EDN-186	2007/03/07	H. Kurimoto		T. Mori
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

## 1. 品名 STUD for Series 6407

## 2. 形式 STUD

## 3. 適用範囲 Scope

本規格は、6407 シリーズ用スタッドに適用し、コネクタと適合基板を組み合わせた状態で下記を満足すること。

This specifies Stud for Series 6407.

The Stud shall meet the performances specified here under the condition with the connector and the applicable card mated.

## 4. 関連規格 Related documentation

- ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクタ試験及び測定- 第 1-100 部: 一般試験一覧  
Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-  
Part 1-100: General-Applicable publications
- ・JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクタ試験及び測定- 第 1-100 部: 一般試験一覧  
Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-  
Part 1-100: General-Applicable publications
- ・JIS C 5402: 1992 電子機器用コネクタの試験法  
Method for Test of Connectors for electronic equipment.

## 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material

図面参照 Refer to drawings.

## 6. 製品型番 Part numbering

XX 6407 001 Y ZZ 804 +

XX-Y : バリエーション A Variation A

- 30-0 : 吸着テープあり with Vacuum Tape
- 84-0 : 吸着テープあり, エンボステープ梱包  
with Vacuum Tape, Embossed Tape Packaging
- 80-0 : 吸着テープなし without Vacuum Tape
- 84-1 : 吸着テープなし, エンボステープ梱包  
without Vacuum Tape, Embossed Tape Packaging

ZZ : バリエーション B Variation B

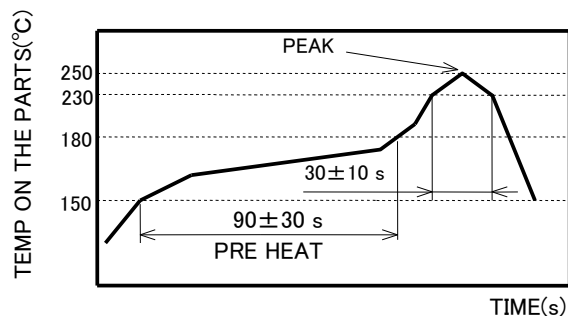
- 00 : for H=4.0(H=+0) with GUIDE(0.8)
- 01 : for H=4.0(H=+0) with GUIDE(0.6)
- 02 : for H=4.0(H=+0) with GUIDE(0.4)
- 03 : for H=5.9(H=+1.9) with GUIDE(0.8)
- 04 : for H=4.0(H=+0) without GUIDE
- 05 : SPECIAL H=3.0 without GUIDE
- 06 : SPECIAL H=0.7 with GUIDE(0.3)
- 07 : SPECIAL H=2.6 without GUIDE
- 08 : SPECIAL H=3.85 with GUIDE(0.4)
- 09 : for H=4.0(H=+0) with GUIDE(0.4) M1.7
- 10 : SPECIAL H=3.0 without GUIDE M1.7
- 11 : SPECIAL H=4.5 without GUIDE(0.8,0.6)
- 12 : SPECIAL H=3.45 with GUIDE(0.8) M1.4

## 仕様 Spec

## 嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件・方法 Condition	規格 Specification
7.一般 General	1	使用温湿度範囲 Operation environment	—	−40℃ ～ 85℃ 95% RH MAX. 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 通電による温度上昇分も含む。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur. Including terminal temperature rise.
	2	保存温湿度範囲 Storage environment	梱包状態にて While packed	−40℃ ～ 85℃ 95% RH MAX. 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur
	3	適合基板厚 Applicable board thickness	—	t=1.0 mm
	4	推奨メモリー基板 Recommended memory board	—	Mini-PCI Express に準拠のこと。

8.物理的 Physical	1	はんだ付性 Solderability	<p>245±3°C のはんだ浴 (Sn-3Ag-0.5 Cu) 3<sub>-1</sub><sup>0</sup> sec. immersion <b>IEC 60068-2-20:1979</b> <b>JIS C 60068-2-20:1996</b></p>	<p>浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.</p>
	2	はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	<p>&lt;手はんだ Hand soldering&gt; はんだごて温度 Bit temperature 350±10°C 5<sub>0</sub><sup>+1</sup> sec. <b>IEC 60068-2-20:1979</b> <b>JIS C 60068-2-20:1996</b> &lt;リフロー Reflow&gt; 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※但し、2 回目は常温に戻した後 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 260°C (コネクタ表面) (On the surface connector) <b>(Modified) IEC 60068-2-58:1999</b> <b>JIS C 60068-2-58:2002</b></p>	<p>端子ガタ、変形等ないこと。 No loose contacts nor deformation.</p>



**特記事項 Special Instructions**

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

- (1) 本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2) 本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。

If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.

- (3) 以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。

If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.

2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

**有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances**

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.